
南亞電路板股份有限公司 2022年上半年營運概況

2022年8月9日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

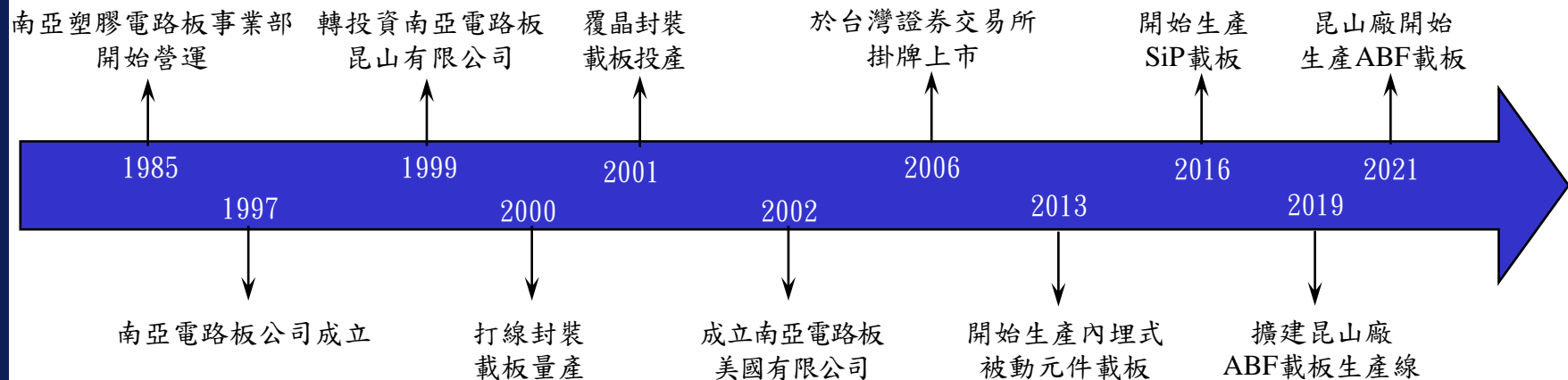
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2022年上半年合併營業額為新台幣 297.4億元。
- 台股上市市值：新台幣1,683.2億元(2022年6月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板



財務狀況

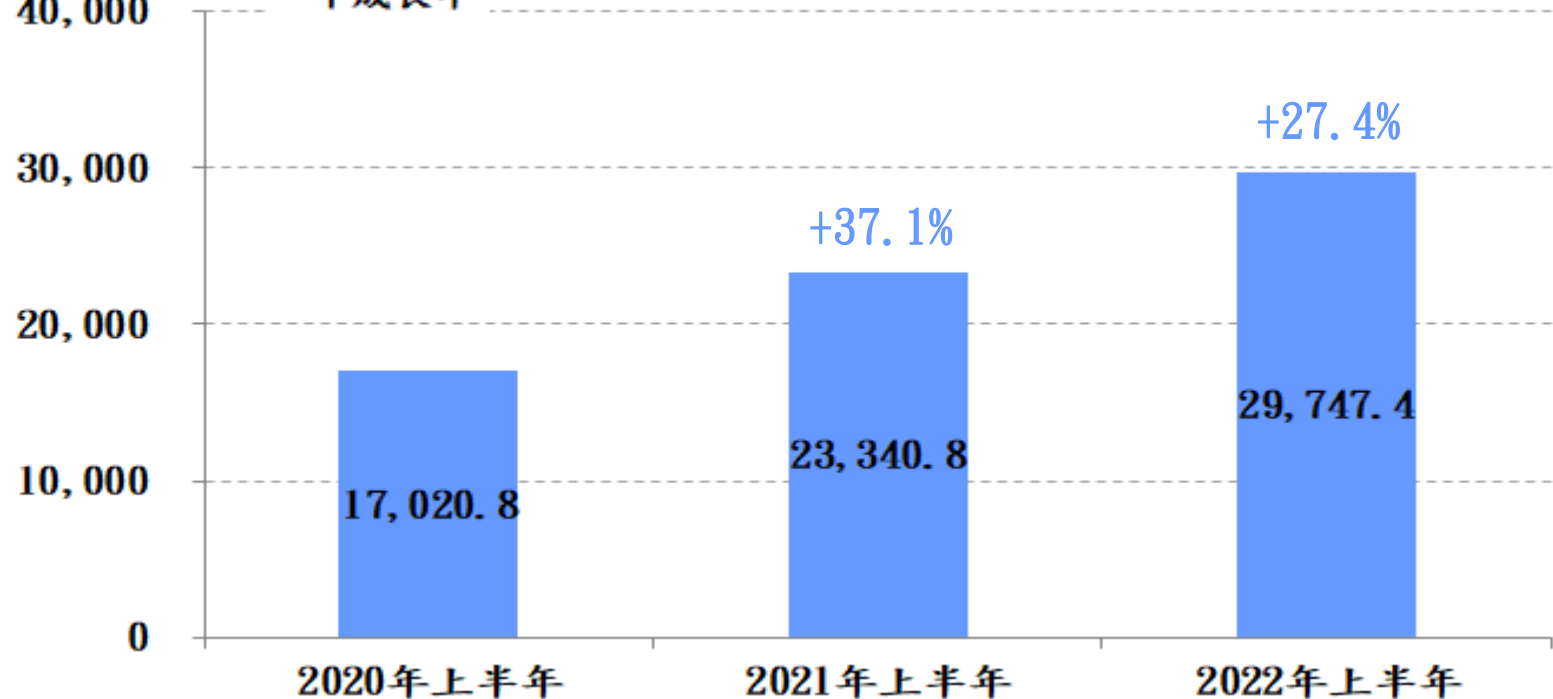
近三年上半年合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

40,000

■ 年成長率



- 2021年上半年營收較2020年上半年增加37.1%:
本公司因遠距商務、居家娛樂等應用產品需求提升，營運績效淡季不淡，2021年上半年營收比2020年同期再成長。
- 2022年上半年營收較2021年上半年增加27.4%:
本公司因大尺寸高層數高階IC載板等高值化產品銷售增加，2022年上半年營收比2021年同期大幅成長。



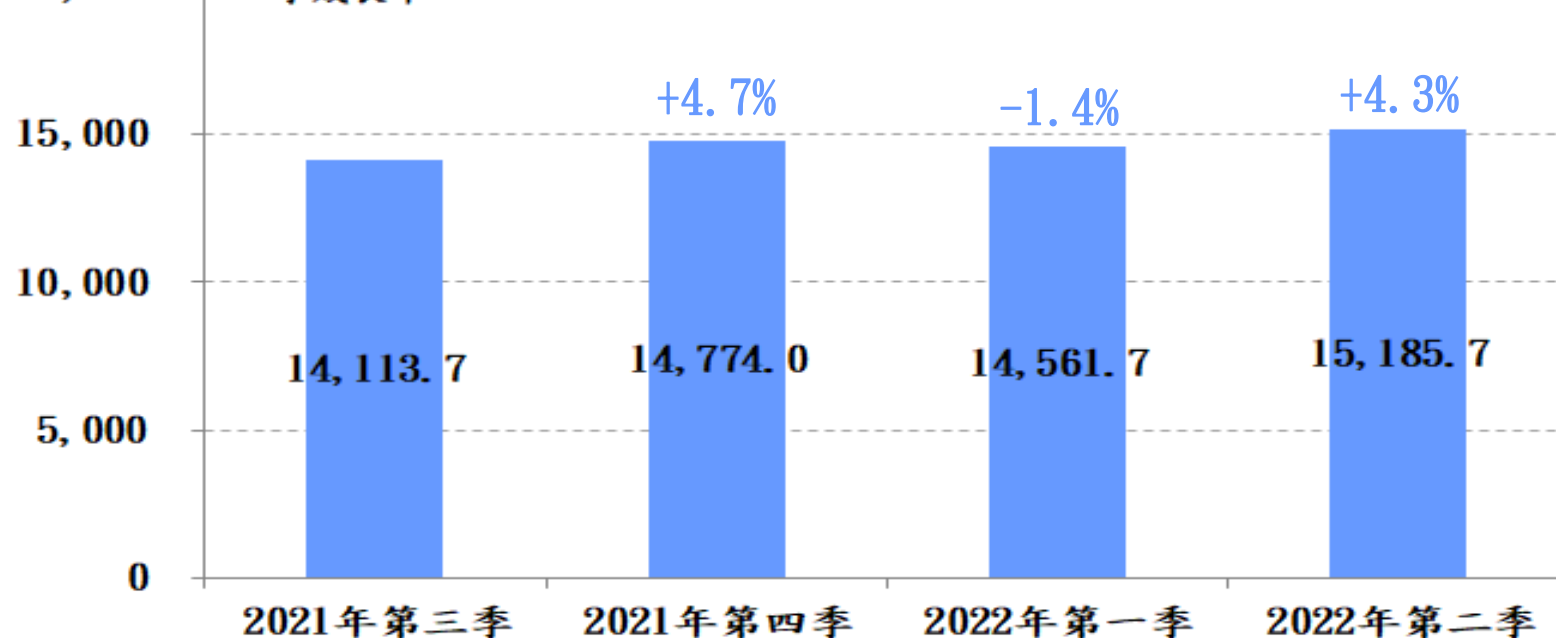
財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

20,000

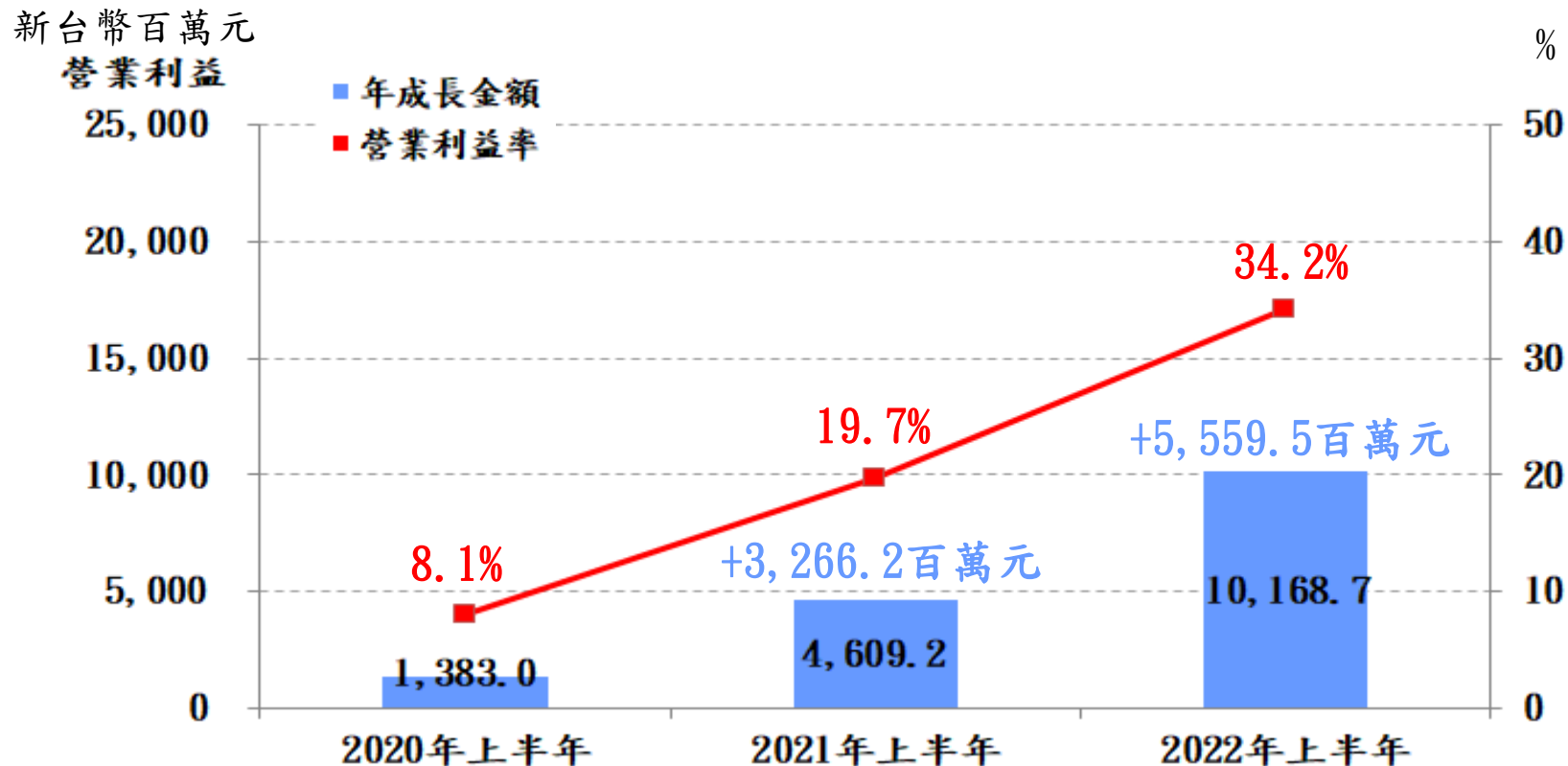


- 2021年第四季營收較2021年第三季增加4.7%:
第四季因高階IC載板銷售持續強勁，營收繼續成長，營運表現淡季不淡。
- 2022年第一季營收較2021年第四季減少1.4%:
2022年第一季因工作天數減少，營收比2021年第四季略為下滑。
- 2022年第二季營收較2022年第一季增加4.3%:
2022年第二季因高值化產品銷售持續成長，抵銷4月昆山廠靜態管理與5月台灣疫情影響，營收比2022年第一季成長。



財務狀況

近三年上半年營業利益

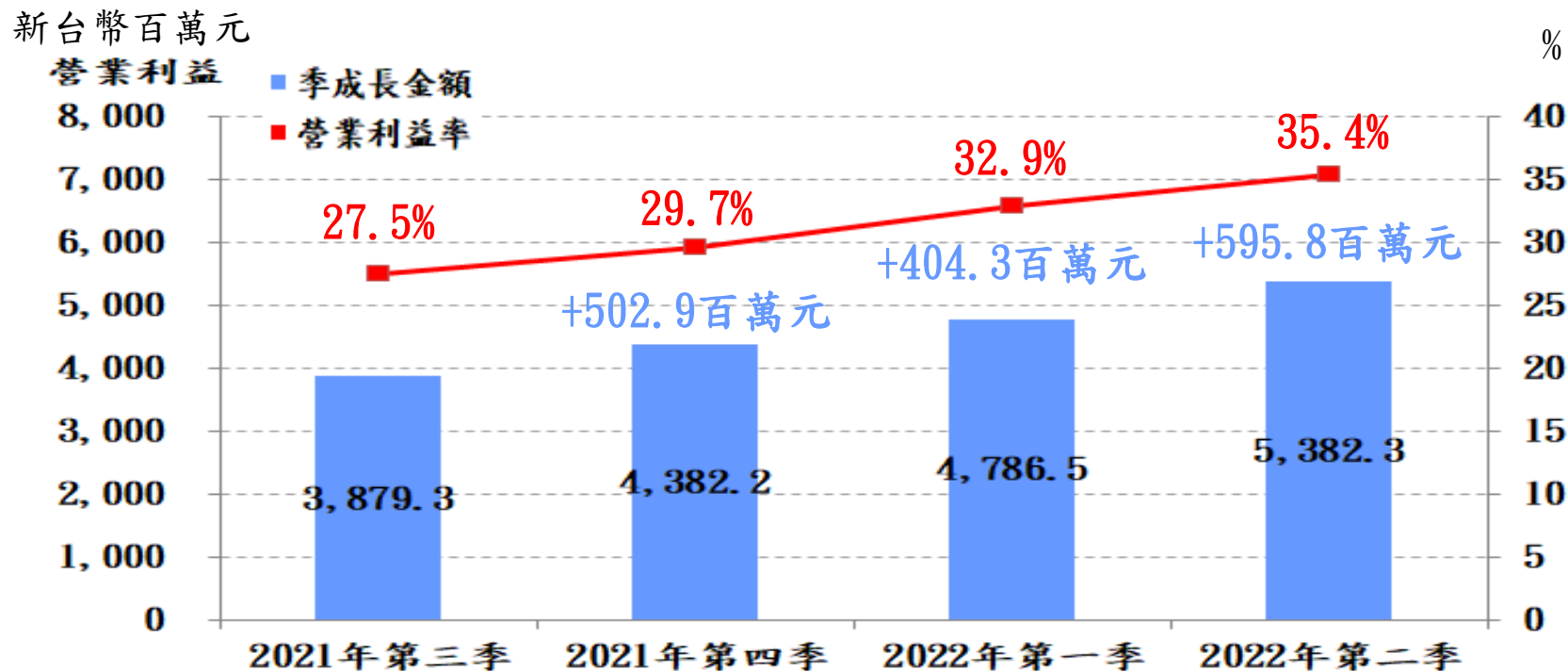


- 2021年上半年營業利益較2020年上半年增加3,226.2百萬元：
本公司除高值化產品銷售增加與IC載板新產能貢獻外，亦持續將人工智慧導入生產管理，優化製程，致2021年上半年營業利益持續提升。
- 2022年上半年營業利益較2021年上半年增加5,559.5百萬元：
本公司針對高階IC載板產能去瓶頸，以增加產出，提升高值化產品銷售，2022年上半年營業利益比2021年同期顯著成長。



財務狀況

近一年每季營業利益

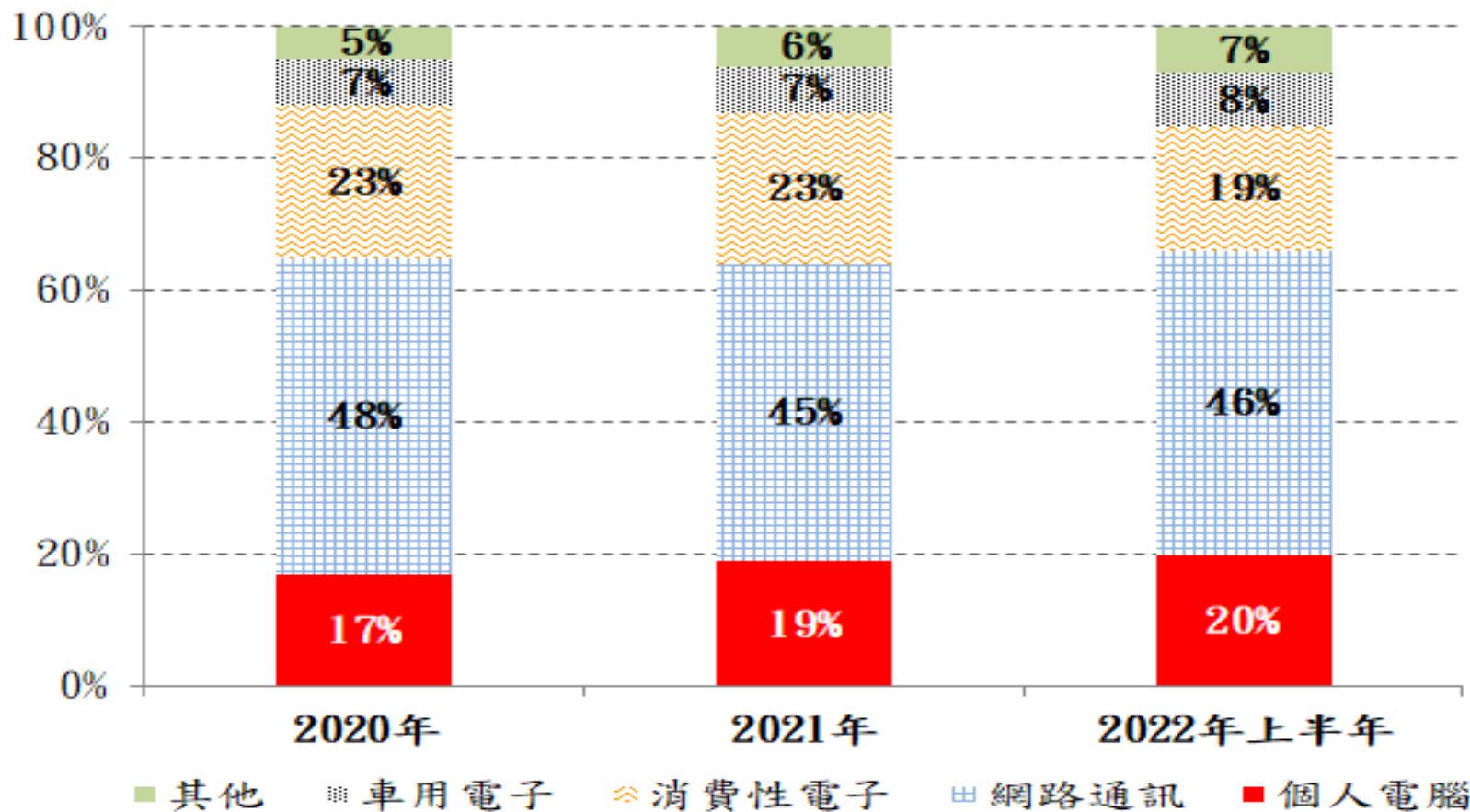


- 2021年第四季營業利益較2021年第三季增加502.9百萬元：
網通、人工智慧及高效運算等高值化產品銷售優於預期，使獲利再成長。
- 2022年第一季營業利益較2021年第四季增加404.3百萬元：
電腦與高效運算等高階IC載板銷售持續成長，進一步提升本公司獲利。
- 2022年第二季營業利益較2022年第一季增加595.8百萬元：
本公司除大尺寸高層數高階IC載板銷售增加外，並導入數位管理、人工智慧改善生產良率與效率，使獲利持續成長。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

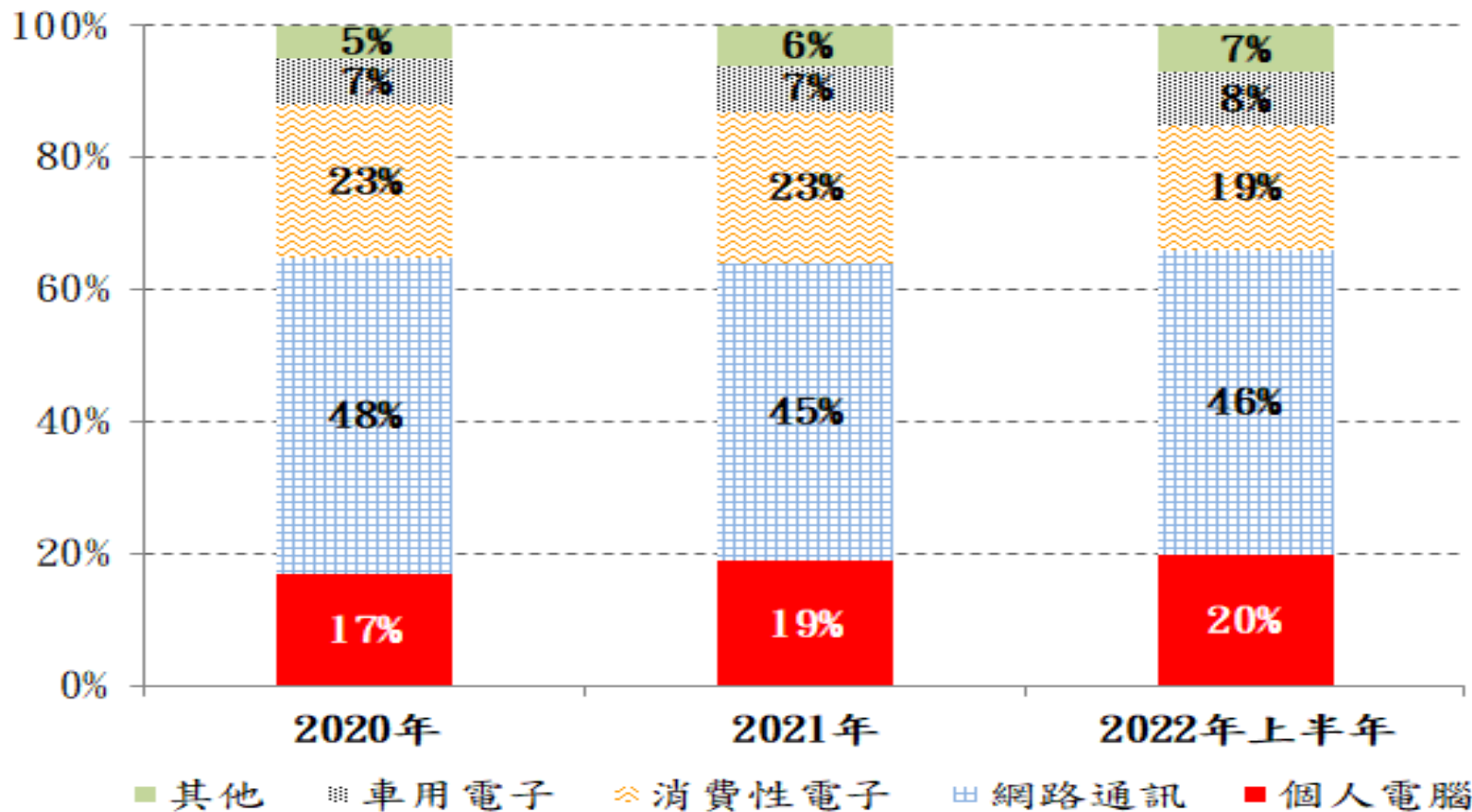


- 本公司因中央處理器載板客戶市占率提升，且高階網通設備需求回溫，2022年上半年個人電腦與網通營收比重提高。
- 受傳統銷售淡季與通貨膨脹影響，消費性電子產品訂單減少，2022年上半年相關營收比重下滑。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 因電動車銷售增加，且汽車採用更多電子設備，帶動車用電路板需求成長，2022年上半年車用電子營收比重增加。
- 本公司積極爭取更多資料中心與邊緣運算商機，大尺寸高層數IC載板銷售增加，2022年上半年相關營收比重再成長。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ 高階ABF載板

透過人工智慧與大數據優化製程，提升製程能力，並微縮增層線寬/線距及bump pitch；另將持續依進度擴建兩岸產能，以進一步擴大市佔率：

1. 5G基地台、雲端伺服器等高階網通載板。
2. 5奈米電腦中央處理器、6奈米繪圖晶片等高階電腦應用載板。
3. 高層板大尺寸人工智慧、加速處理器等特殊應用晶片載板。

■ 高階BT載板

持續強化製程能力，微縮MSAP製程線寬/線距，同時開發並爭取高階BT載板商機，將量產：

1. 新世代穿戴裝置、高階手機相機模組及光學感測器SiP載板。
2. 5G微型基地台收發器與網路訊號交換器器應用載板。
3. 高階車用影音娛樂、微控制器及通訊應用載板。

■ 高密度連接板(HDI)

因行動裝置、消費性及車用電子等產品設計愈趨精密，高值化之HDI使用量持續增加，本公司將提升高階HDI產品比重，開發並量產：

1. 高階電腦主機板與伺服器加速卡。
2. 消費型固態硬碟與記憶體模組。
3. Mini LED應用電路板。



未來營運目標

公司營運績效持續成長

- 培養優秀的研發與製程技術人才，再強化研究開發量能，增加產品附加價值。
- 參與客戶設計，共同開發及提供原生數據，分享生產資訊，縮短交期。
- 持續針對2.5D/3D先進封裝趨勢發展，開發更多高階IC載板，以提升高值化產品銷售比重。
- 持續將人工智慧導入營運管理模式，推動智能化生產，並優化製程條件與設備效能，以軟硬並進的策略，提升良率與效率。
- 本公司擴建之高階IC載板產能可望提前投產：
 - 樹林廠ABF載板第一期擴建：由23Q1提前至22Q3陸續投產
 - 昆山廠ABF載板第二期擴建：由23Q1提前至22Q3陸續投產
 - 樹林廠ABF載板第二期擴建：依計畫維持24Q1投產
- 持續推動ESG專案，訂定國際科學基礎減碳目標，落實企業社會責任。



感謝您的聆聽

